【原因、判断要点、发生工序】不锋利模具冲切时受到冲击,或者设计上脆弱的邮票孔受到冲击所引起的(冲切工序)。

[Causes/processes involved/keys to judgment]

The cracking takes place by a shock given by a dull punching die or along the mechanically weak perforation. (Punching process)



[コメント] 顕微鏡倍率× I注#1 显微镜倍率× [Coments] Magnification:×

6-1-7 プッシュバック加工外れ/回压的脱位 / Detached push back board

【特徴】プッシュバック加工品の一部が外れたり、 外れかかっている状態の欠陥

【特征】回压产品的局部脱位、或者将要脱位的缺陷。

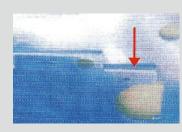
[Characteristics] A portion of a board formed by push back process comes off or is about to come off.

【原因・判断ポイント・発生工程】 プッシュバック 加工金型異常、プッシュバック加工時の異物介在、プッシュバック加工完了後の取扱い不良などにより 出来たもの(プッシュバック加工〜プッシュバック加工後)

【原因、判断要点、发生工序】回压的模具异常、回 压时夹杂杂物、回压后的处理不良等所引起的(回压 ~回压后).

[Causes/processes involved/keys to judgment]

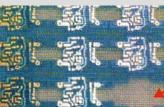
The defect is caused by a defective push back die, the presence of a foreign object in push back operation, and poor handling after push back process (Push back process - after push back process)



【コメント】 顕微鏡倍率×

显微镜倍率×

[coments] Magnification: ×



顕微鏡倍率×

^{【注释】} 显微镜倍率×

[coments] Magnification: ×

6-1-8 プレス欠け/冲切的缺口 / Chipped board by punching

【特徴】打ち抜きプレス加工品の基板が欠けている 状態の欠陥

【特征】冲切板件有缺口的缺陷。

[Characteristics] A punched board is chipped



[コメント] 顕微鏡倍率× [注释] 显微镜倍率×

[Coments]
Magnification: ×

【原因・判断ポイント・発生工程】打ち抜きプレス 金型の切れ味不良、打ち抜きプレス加工時の異物介 在などで出来たもの(打ち抜きプレス工程)